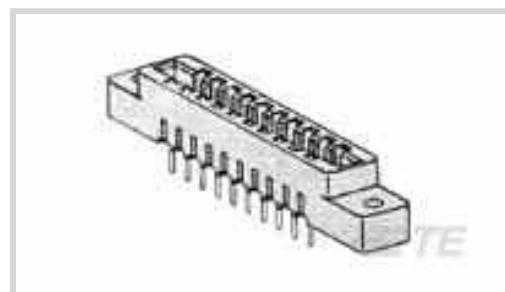




Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Card-Edge-Steckverbinder > Standard-Edge-Steckverbinder



Steckverbindersystem: **Leiterplatte-an-Leiterplatte**

Anzahl von Positionen: 15

Raster: 3.18 mm [.125 in]

Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: **Lötöse**

Anzahl der Doppelpositionen: 15

Eigenschaften

Produktmerkmale

Steckverbindersystem	Leiterplatte-an-Leiterplatte
Steckverbinder- und Gehäusotyp	Buchse
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

Anzahl von Positionen	15
Anzahl der Doppelpositionen	15
Zeilenanzahl	2
Ladungszustand des Steckverbinderkontakts	Voll bestückt
Montageausrichtung für Leiterplatte	Vertikal

Sonstige Eigenschaften

Primäre Produktfarbe	Grün
----------------------	------

Kontaktmerkmale

Kontaktfestsit im Gehäuse	Mit
Dicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	2.54 µm[100 µin]
Kontakttyp	Stecksockel
Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts	.76 µm
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Gold
Oberfläche des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Hell
Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts	Nickel

Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Zinn
---	------

Kontaktmaterial	Phosphorbronze
-----------------	----------------

Kontakt-nennstrom (max.)	5 A
--------------------------	-----

Klemmenmerkmale

Anschlussstift- und Restlänge	7.11 mm [.28 in]
-------------------------------	------------------

Verbindungsmethode für Leiterplatte	Durchsteckmontage - Löten
-------------------------------------	---------------------------

Anschlussmethode für Leitungen und Kabel	Lötöse
--	--------

Montage und Anslusstechnik

Gegensteckarretierung	Ohne
-----------------------	------

Gegensteckführung	Ohne
-------------------	------

Typ des Kontaktfestsitzes im Gehäuse	Rastfeder
--------------------------------------	-----------

Montageausrichtung der Leiterplatte	Ohne
-------------------------------------	------

Arretierung für Leiterplattenmontage	Mit
--------------------------------------	-----

Art der Leiterplattenmontage	Montagegriffe
------------------------------	---------------

Art der Steckverbinder-montage	Leiterplattenmontage
--------------------------------	----------------------

Gehäusemerkmale

Raster	3.18 mm [.125 in]
--------	-------------------

Gehäusematerial	Mit Glas gefülltes Polyester
-----------------	------------------------------

Abmessungen

Karteneinschubtiefe	7.49 mm [.29 in]
---------------------	------------------

Steckverbinderhöhe	11.68 mm [.46 in]
--------------------	-------------------

Reihenabstand	5.97 mm [.235 in]
---------------	-------------------

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-55 – 105 °C [-67 – 221 °F]
---------------------------	-----------------------------

Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung	Leistung
----------------------	----------

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	120
------------------	-----

Verpackungsmethode	Tray
--------------------	------

Weitere

Card Edge Connectors Comment	Intercontact Keying Plug Part Number
------------------------------	--------------------------------------

650025-2.

Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2023 (233) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br oder Cl > 900 ppm.
Lötfähigkeit	Wellenlötfähig bis 240 °C

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



Kunden kauften auch diese Produkte



Dokumente

Produktzeichnungen

CONN LOW PRO 15 POS 125SOL-EYE

Englisch

Produktspezifikationen

Produktspezifikation

Englisch